



Newsletter 1/2009

Einladung zur SMT/Hybrid/Packaging 2009 vom 05. - 07. Mai 2009



In allen Bereichen 1a

Auf den Gebieten elektronische Steuergeräte, Leiterplattendesign und Baugruppenfertigung genügen wir international höchsten technologischen Ansprüchen. Unsere High-End Baugruppen werden in vielfältigen Bereichen angewendet.

- Automobilelektronik
- Mess- und Regeltechnik
- Verteidigungstechnik
- Konsumer-Anwendungen
- Medizintechnik

Von Design und Entwicklung über Leiterplattenfertigung, Bauelemente, Aufbau- und Bestückungstechnologie bis hin zu Test-Equipment – auf der SMT/Hybrid/Packaging 2009 in Nürnberg, Europas größter Spezialmesse für Systemintegration in der Mikroelektronik, finden Sie alles kompakt und übersichtlich unter einem Dach.

Auch wir als Smart Electronic Engineering and Manufacturing Service (SEEMS) Unternehmen nutzen diese Gelegenheit und stellen unser umfangreiches Leistungsspektrum vor.

Erleben Sie unser zukunftssträchtiges Unternehmen hautnah und besuchen Sie uns in **Halle 6, Stand 6-210**. Dort steht unser kompetentes Team jederzeit für ein persönliches Gespräch bereit.

Damit Sie die Zeit für Ihren Messebesuch auch umfassend nutzen können, bieten wir Ihnen bereits jetzt die Zusendung eines **kostenlosen Eintrittsgutscheins** an. Damit können Sie sich vorab unter www.mesago.de registrieren und erhalten Ihre persönliche Dauerkarte zugeschickt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



© Eltroplan GmbH
Eltroplan GmbH | Vogesen Straße 7 | 79346 Endingen
Tel: +49 (0)7642 9049-0 | Fax: +49 (0)7642 9049-49 | info@eltroplan.com

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte [hier](#).

